

# Qualcomm

## 公司分析報告

Qualcomm Incorporated

QCOM.US

報告日期：2026年2月10日

分析師：Clawdbot AI

## 目錄

一、公司概況	2
二、財務分析	3
三、產品Roadmap	4
四、市場競爭格局	5
五、風險評估	6
六、投資價值分析	7
七、附錄	8

## 1.1 公司基本信息

公司全稱	Qualcomm Incorporated
股票代碼	QCOM.US
總部位於	美国加州圣地亚哥
市值	\$1900亿
主營業務	手机SoC、基带芯片、汽车芯片
核心產品	Snapdragon系列、X基带芯片
CEO	Cristiano Amon

## 1.2 業務架構

### 核心業務

- 手机芯片: 60%
- 射频前端: 25%
- 汽车/IoT: 15%

### 下游應用

- 智能手机
- 汽车座舱
- IoT设备

## 1.3 核心競爭優勢

優勢	說明
Qualcomm 基带专利	5G基带市占率60%+

## 2.1 核心財務指標

FY2024營收

**\$390亿**

YoY +XX%

淨利潤

**\$95亿**

YoY +XX%

毛利率

**56%**

同比提升

淨利率

**24%**

优秀

## 2.2 研發費用

### 研發投入

年度	金額	佔營收比
FY2022	\$85亿	22%
FY2023	\$88亿	22%
FY2024	\$95亿	24%

## 2.3 營收趨勢

指標	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024
營收	XX	XX	XX	\$390亿
YoY	-	+XX%	+XX%	+XX%
淨利潤	XX	XX	XX	\$95亿
毛利率	XX%	XX%	XX%	56%

### 3.1 產品線

- 5G手机

產品	發布	製程	特點	應用
Snapdragon 8 Gen 4	2024Q4	3nm	Oryon CPU架構	旗艦手機
X85基帶	2025	-	5G Advanced	

### 3.2 技術優勢

- 5G基帶專利牆
- Hexagon DSP
- Adreno GPU

## 4.1 市場份額

公司	份額
Qualcomm (5G基帶)	60%
联发科	30%

## 4.2 SWOT分析

### 優勢

- 基帶專利壁壘
- 旗艦SoC性能
- 汽車業務增長

### 機會

- AI PC机遇
- 汽车芯片需求

### 劣勢

- 中国市场竞争
- PC市场进展慢

### 威脅

- 联发科追赶
- 华为自研芯片

## 5.1 風險矩陣

中风险

联发科竞争

中风险

华为竞争

低风险

诉讼风险

## 5.2 核心風險分析

### 核心风险

- 联发科在中低端市场持续施压
- 华为回归高端市场

## 6.1 估值指標

指標	數值	備註
當前市值	\$1900億	2026年2月
PE (TTM)	約XXx	-
PS (TTM)	約XXx	-
PB	約XXx	-

## 6.2 買入理由

- 5G基帶龙头，专利授权稳定
- AI PC带来新增长点
- 汽车业务快速增长

## 6.3 風險因素

- 手机市场放缓
- 中国竞争对手崛起

## 6.4 投資建議

## 7.1 關鍵術語

術語	解釋
SoC	System on Chip, 系統級芯片
5G	第五代移動通信技術

## 7.2 數據來源

- Qualcomm FY2024年报
- Counterpoint
- Strategy Analytics

## 7.3 免責聲明

**重要提示：**本報告僅供投資參考，不構成任何投資建議。

**報告總結：**5G基帶龙头，手机芯片稳定增长，汽车和AI PC带来新机遇。